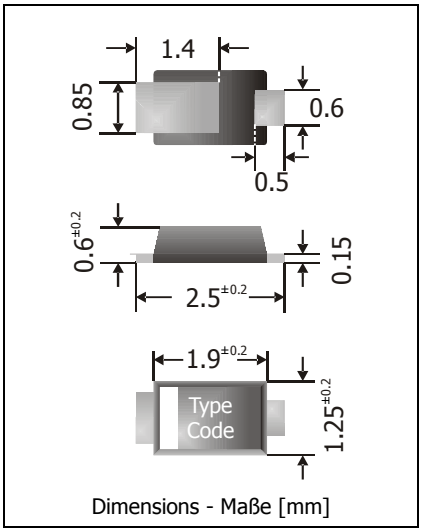
SDB13HS, SDB14HS

Surface Mount Schottky Barrier Diodes
Schottky-Barrier-Dioden für die Oberflächenmontage

Version 2014-07-11



Dimensions - Maße [mm]

Nominal current Nennstrom	1000 mA
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	30 V, 40 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	Power SOD-323
Weight approx. Gewicht ca.	0.005g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	

Maximum ratings (T_A = 25°C) **Grenzwerte (T_A = 25°C)**

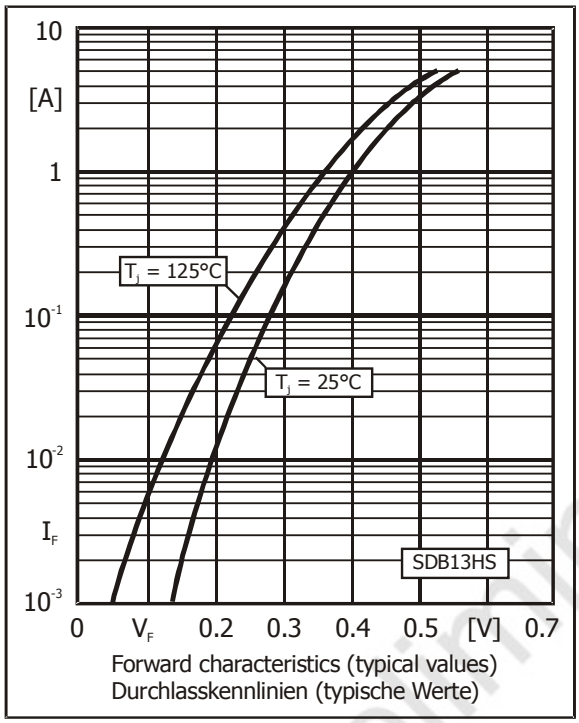
Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Forward voltage Durchlass-Spannung V_F [V] [1]	Marking Kennzeichnung
SDB13HS	30	< 0.47	A3
SDB14HS	40	< 0.52	U4

Power dissipation – Verlustleistung		P_{tot}	600 mW [2]
Max. average forward current – Dauergrenzstrom (dc)		I_{FAV}	1000 mA [2]
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	f > 15 Hz	I_{FRM}	0.9 A [2]
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle	T_A = 25°C	I_{FSM}	4.4/5 A
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_S	-40...+125°C -40...+125°C

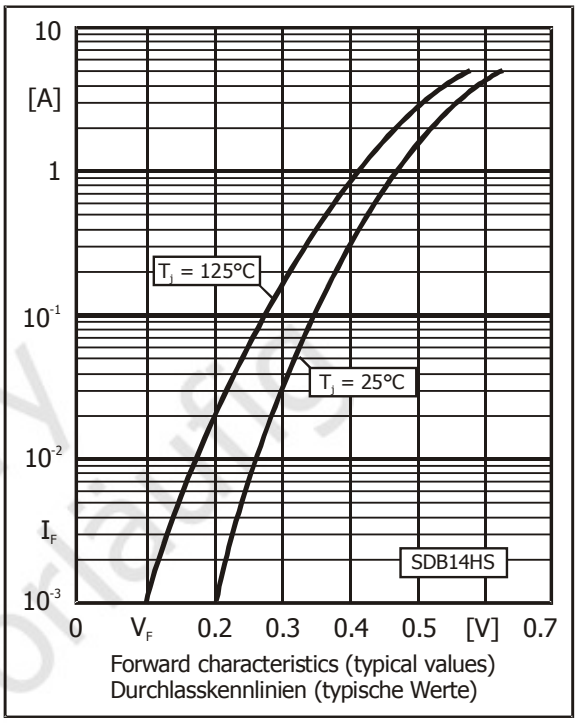
1 I_F = 1 A, T_j = 25°C
2 Mounted on P.C. board with 36 mm² copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 36 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss

Preliminary
Vorläufig

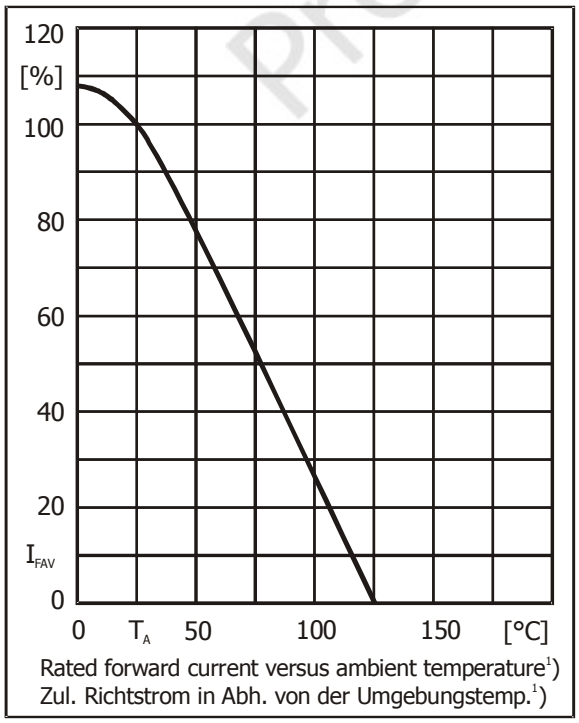
Characteristics				**Kennwerte**
Leakage current Sperrstrom	T_j = 25°C	V_R = 5 V V_R = V_{RRM}	I_R I_R	< 40 µA < 200 µA
Junction Capacitance Sperrschichtkapazität	V_R = 10 V	f = 1 MHz	C_j	typ. 30 pF
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			R_{thA}	< 170 K/W [1])



Forward characteristics (typical values)
Durchlasskennlinien (typische Werte)



Forward characteristics (typical values)
Durchlasskennlinien (typische Werte)



Rated forward current versus ambient temperature[1])
Zul. Richtstrom in Abh. von der Umgebungstemp.[1])

Preliminary Vorläufig

1 Mounted on P.C. board with 36 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 36 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss

 © Diotec Semiconductor AG